

德邦科技：专注高端电子封装材料领域 让“小巨人”撑起“大创新”

——烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

烟台德邦科技股份有限公司董事长
烟台德邦科技股份有限公司董事、总经理
烟台德邦科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监

解海华先生
陈田安先生
于 杰先生

东方证券承销保荐有限公司董事总经理、保荐代表人
东方证券承销保荐有限公司保荐代表人

苗 健先生
王国胜先生

烟台德邦科技股份有限公司 董事长解海华先生致辞



术开发和产业化，以满足下游应用领域前沿需求,提供创新性解决方案,在高端电子封装材料领域构建起了完整的研发生产体系并拥有完全自主知识产权。

德邦科技汇聚了一批行业高精尖研发人员,凭借强大的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务,已进入知名品牌客户的供货体系,并入选国家工业和信息化部专精特新“小巨人”企业,荣膺全国电子信息行业优秀企业、山东省首批“瞪羚企业”等称号。

未来,德邦科技将继续深耕半导体先进封装行业,通过资本整合,实施“1+6+N(New)”的市场战略,实现快速发展,让“小巨人”撑起“大创新”!

德邦科技将以本次发行和上市为契机,通过募集资金投资项目的顺利实施,进一步扩大市场占有率与影响力,提升与巩固公司行业领先地位,以最饱满的热情和最好的服务,与广大客户共襄发展,共享未来!

通过今天的交流,我们希望各位投资者能客观、全面地了解德邦科技,能够更准确地把握德邦科技的投资价值和投资机会,给予德邦科技持续的关注和支持。我们也会充分听取投资者们的意见,不断推动公司的创新发展,相信在广大投资者的高度信任和大力支持下,德邦科技的发行工作必将圆满完成。

最后,再次感谢投资者朋友、社会各界对德邦科技的关心,你们的积极参与,就是对我们最大的支持与鼓励。德邦科技上市后,将一如既往地不断提升企业竞争力,提高企业经营管理水平,提升企业盈利能力,反哺社会、回馈投资者。谢谢大家!

尊敬的各位嘉宾、投资者,朋友们:

大家好!

非常高兴有机会通过网络平台,就烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市进行即时的网上交流。首先,我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工,向长期关心、支持德邦科技的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢!并向参加今天网上交流的朋友们表示诚挚的欢迎!

天道酬勤,商道酬信。德邦科技作为一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业,产品主要包括集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料四大类别。

德邦科技始终秉持“致力于成长为中国半导体封装材料、电子材料、新能源材料等行业的引领者和全球强有力的竞争者”的企业愿景,聚焦集成电路、智能终端、新能源等战略新兴产业核心和关键材料的技



企业风采图

经营篇

问:公司的主营业务是什么?

陈田安:公司是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业,产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,广泛应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域。

问:公司有多少家控股及参股子公司?

苗健:截至招股说明书签署日,公司拥有4家全资子公司和1家控股子公司,不存在参股公司。

问:请介绍公司取得的科技成果与产业深度融合的具体情况。

陈田安:经过多年的技术积累、核心人员不断加入、产品研发迭代、客户认证等,公司在产品配方复配、关键单体合成、生产工艺设计、产品检测等环节形成了自己的核心技术,产品广泛应用于集成电路、智能终端、动力电池、光伏叠瓦等新兴行业领域,实现了核心技术的有效转化,建立起完善的自主知识产权和产品体系。经过多年发展,公司具备独立自主研发、生产和销售的能力,公司的科研创新以实现产业化落地为目的,科技成果与产业融合度较高。

问:公司拥有多少专利权?

陈田安:截至招股说明书签署日,公司拥有境内专利 145 项,境外专利 1 项。

问:公司拥有多少注册商标?

陈田安:截至招股说明书签署日,公司拥有 32 个注册商标。

问:公司拥有多少软件著作权?

陈田安:截至招股说明书签署日,公司共拥有 6 项软件著作权。

问:请介绍公司参与的重大科研项目情况。

陈田安:公司先后参与实施了多项国家级、省级重大科研项目,作为课题单位承担了“晶圆减薄临时粘结剂开发与产业化”“用于 Low-k 倒装芯片 TCB 工艺的底部填充材料研发与产业化”“高性能热界面材料规模化研制开发”三项国家“02 专项”项目,作为参与单位承担了“MW 级风力发电机组风轮叶片原材料国产化”“高效半导体照明关键材料技术研发”两项国家“863 计划”项目,作为项目牵头单位承担了国家重点研发计划“窄间距大尺寸芯片封装用底部填充胶材料(underfill)应用研究”项目、山东省重点研发计划“集成电路封装关键材料开发与产业化技术”项目和“高端服务器封装关键材料技术开发与产业化”项目,作为课题单位承担一项国家级“A 工程”课题项目。

问:请介绍公司的合作研发情况。

陈田安:报告期内(2019 年至 2021 年,下同),公司实质开展合作研发项目情况为:2020 年 10 月,公司与哈尔滨工程大学烟台研究院签署了《战略合作框架协议》,围绕集成电路封装、半导体组装、高效新能源、先进制造领域所用的特种功能高分子界面材料等先进技术领域,通过建立技术信息互通机制,联合开展重大项目科学研究、技术攻关和成果转化,共同组建联合实验室,人才联合培养、人才互聘等合作模式,搭建“产、学、研”合作交流平台,共同提升我国新材料的国际竞争力,服务新材料制造工艺与技术的发展。目前双方共建的“先进合成高分子材料”联合实验室已经启用,针对“关键原料固化剂合成”“UV 湿气双固化反应型聚氨酯热熔胶”及“低气味、低收缩、高强度双组份丙烯酸酯混体系结构粘接剂研究”展开合作。公司与高校的合作研发将进一步提升公司的研发实力,能够更快应对市场的技术迭代。

问:公司的营业收入是多少?

于杰:报告期内,公司营业收入分别为 32716.64 万元、41716.63 万元和 58433.44 万元,2019 年至 2021 年营业收入复合增长率为 33.64%,呈现持续上升趋势,公司具有良好的盈利能力和持续发展能力。

问:公司主营业务毛利率是多少?

于杰:报告期内,公司主营业务毛利率分别为 40.02%、34.88%和 34.59%。

问:公司的研发费用是多少?

于杰:报告期内,公司研发费用分别为 1973.42 万元、2415.04 万元和 3066.42 万元,整体呈现逐年增长趋势,且研发费用构成整体较为稳定。

发展篇

问:公司未来的发展规划是什么?

解海华:公司将继续锁定集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应

用材料四个发展方向,实施“1+6+N(New)”的市场发展战略,以“集成电路封装到智能终端封装等电子系统封装”为一个主链条,重点贯穿集成电路封装、智能终端模组、平面显示、新能源动力电池、光伏电池、高端装备 6 个细分应用市场,在半导体先进封装等新兴(N)细分市场通过资本整合,拓展新领域,实现快速发展。

公司坚持客户导向、市场引导、技术创新,将继续实施大项目、大客户战略。以敏锐的市场洞察力,进行先导性研发、战略合作项目开发,突出自主创新优势,稳抓市场机会;加强销售渠道建设、销售体系建设,进行深度市场调研,精准捕捉市场动态,以高品质产品、优质的服务水平提高市场份额;通过内部质量管理、学习成长平台搭建、文化构建等方式,打造企业软实力;通过降本增效、运营流程梳理等方式提升企业管理水平、盈利水平,确保达到年度业绩、利润目标。

问:请介绍公司的产能提升计划。

解海华:公司持续围绕业务板块及主推产品,按照“以销定产”的原则进行生产计划安排。智能终端封装材料、新能源应用材料作为成长期产品,产量上保证一定幅度增长。为确保公司产品及时供应,公司根据销售预测及产品需求计划,对设备进行改造和更新以完善产品体系,新建并改造产业化项目,新建研发中心,以促进企业技术进步、增强企业内在发展能力以及对外界环境变化的适应能力。

公司坚持自主可控、合理高效布局。结合现有烟台、深圳、张家港、东莞四个研发生产基地,进行长三角及东南亚业务规划,加强产能配套能力,加快自动化工厂建设进程,推动已有设备自动化升级,实现精准化生产,工艺参数全过程记录,严格管控“人、机、料、法、环”五大影响因素,实施全面质量管理,提高企业生产制造水平。

问:公司的竞争优势有哪些?

陈田安:公司的竞争优势有:1)研发、生产优势;2)客户资源优势;3)产品定位高端及产品结构优势;4)丰富的系统解决方案优势。

问:请介绍公司的客户资源优势。

陈田安:经过多年发展,公司的芯片固晶材料、晶圆 UV 膜等集成电路封装材料已在国内多家知名封测企业批量供货;智能终端封装材料已应用于苹果、华为、小米科技等众多智能终端品牌;同时还积累了宁德时代、通威股份等优质客户资源。这些优质的客户资源是公司进一步发展的重要保障,公司将继续通过研发提供新产品和电子材料解决方案,并提供优质的服务提升客户忠诚度。

问:请介绍公司的技术储备情况?

陈田安:多年来,公司持续投入研发力量,对新产品和新工艺进行研究,以推动产业升级和进步,抓住未来市场机遇。公司将继续以高端电子封装行业的发展方向为指导,围绕现有产品及技术成果,在新产品研发、产品优化、工艺设计等方面进行深度研发及技术攻关,积极引进国内外先进的技术经验,同时加大对科研配套设施改造和更新的投入,为未来发展奠定坚实的技术基础。除已形成规模生产的核心产品外,公司还储备了一批前沿的产品和技术,为公司的持续发展和持续竞争力提供了有力保障,公司储备的产品主要是处于研发阶段,储备的核心技术主要为各产品对应的配方复配技术。

行业篇

问:公司所处什么行业?

陈田安:根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“电子专用材料制造行业(C3985)”;根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司产品属于“3新材料产业—3.3先进石化化工新材料—3.36专用化学品及材料制造(C3985 电子专用材料制造之互联与封装材料)”;根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司集成电路封装材料、智能终端封装材料、动力电池封装材料,属于“1 新一代信息技术产业—1.2 电子核心产业—1.2.3 高储能和关键电子材料制造”,光伏叠晶材料属于“6 新能源产业—6.3 太阳能产业—6.3.2 太阳能材料制造”。

问:请介绍高端电子封装材料的范围、行业规模及未来发展前景。

陈田安:针对不同的封装级别,高端电子封装材料包括电子封装、电子装联材料,主要材料种类有:灌封、包封和塑封材料、陶瓷和玻璃、焊

接材料、电镀与沉积金属涂层、键合材料、印制电路板材料、封装基板、电子封装和装联用粘合剂、下填料和涂层以及热管理材料等,产品种类众多,应用领域极为广泛,尚无权权威市场规模统计。

公司产品系以电子级粘合剂为核心,广泛应用于集成电路、智能终端、光伏叠瓦、动力电池等新兴产业领域,同类产品的行业规模情况为:

1)集成电路封装领域:公司集成电路封装材料中芯片固晶材料等产品属于半导体材料中的封装树脂、芯片粘接材料,根据 SEMI 数据测算,国内 2020 年半导体材料封装树脂、芯片粘接材料业务规模约为 43.61 亿元。公司晶圆 UV 膜产品属于半导体制造中的工艺与辅助材料,根据国机精工《华融证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》数据测算,2020 年全球晶圆 UV 膜市场空间约 28.05 亿元,预计到 2025 年行业规模约为 43.18 亿元。

2)智能终端封装领域:公司智能终端封装材料下游应用领域、产品品牌、产品型号较多,同时用胶点和用量均为定制化使用,用胶点和用量均为下游领域各客户的商业机密,相关数据难以获取。随着下游智能手机、TWS 耳机等智能终端快速发展,智能终端封装材料的应用领域和需求不断扩大。

3)动力电池应用领域:公司动力电池应用材料主要用于新能源动力电池的结构粘接、导热等,根据行业动力电池包用胶量的经验数据,结合动力电池出货量,估算 2020 年全国动力电池封装材料行业规模约为 6.80 亿元。随着动力电池的快速增长,封装材料需求大幅增长,预计到 2025 年行业规模约为 48.22 亿元。

4)光伏电池封装材料:公司光伏电池封装材料主要应用于光伏叠瓦组件的结构粘接、导电等,根据行业光伏叠瓦组件用胶量的经验数据,结合光伏叠瓦组件的出货量,估算全国 2020 年光伏叠晶材料的行业规模约为 3.03 亿元,预计到 2023 年行业规模约为 9.31 亿元。

问:行业面临的机遇有哪些?

陈田安:行业面临的机遇有:1)国家政策大力扶持,行业保持快速增长;2)下游应用领域的发展将为高端电子封装材料行业释放新需求;3)国产品牌技术升级,未来市场空间广阔;4)动力电池、光伏发电产业链发展成熟有利于带动行业发展。

发行篇

问:请介绍公司的控股股东和实际控制人。

苗健:解海华、陈田安、王建斌、林国成及陈昕五人合计控制公司 50.08%表决权,为公司控股股东、共同实际控制人。

问:公司是否存在国有股份?

于杰:截至招股说明书签署日,公司共有 1 名国有股东,为国家集成电路基金(SS)。

问:公司选择的科创板具体上市标准是什么?

王国胜:公司根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》的要求,结合企业自身规模、经营情况、盈利情况等要素综合考量,选择的具体上市标准为:“预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

问:公司本次发行多少股?

王国胜:公司本次公开发行股份数量不超过 3566 万股(不含采用超额配售选择权发行的股份数量),占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。本次发行可采用超额配售选择权,超额配售选择权不得超过 A 股发行规模的 15%。

问:公司本次募集资金投向是什么?

解海华:公司本次募集资金将用于高端电子专用材料生产项目、年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目、新建研发中心建设项目。

问:请介绍公司本次募集资金投向科技创新领域的情况。

解海华:公司本次募集资金均投向科技创新领域,通过募集资金投资项目的实施,公司高端电子封装材料生产能力将得到提升,生产与技术研相关的设备、资金、人员的投入将进一步加强,本次发行募集资金投入项目均围绕主营业务开展,用途明确,重点突出。

文字整理 姚桐

主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)

东方证券承销保荐有限公司 董事总经理、保荐代表人苗健先生致辞



尊敬的各位嘉宾、各位投资者,朋友们:

大家好!

首先,我谨代表东方证券承销保荐有限公司,对所有参加烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介活动的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

德邦科技是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业,公司及子公司先后承担了多项国家级、省部级重大科研项目,在行

业内有着深远的影响。

作为德邦科技首次公开发行 A 股股票的保荐机构和主承销商,在与德邦科技合作的过程中,我们见证了公司在发展过程中取得的骄人业绩,也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。我们坚信,德邦科技上市必将给企业带来新的发展机会,给投资者带来新的投资机会,给资本市场增添新的生机和活力!

作为保荐机构和主承销商,我们将一如既往地履行保荐职责和持续督导义务,勤勉尽责,持续陪伴德邦科技不断发展壮大,并对德邦科技的未来发展充满期盼。

我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动,广大投资者能够更加深入地了解德邦科技,从而更准确地把握德邦科技的投资价值和投资机会。我们相信德邦科技能够通过自己脚踏实地的不懈努力,给广大投资者交出一份满意的答卷,以优良业绩回报股东、回报社会、回报投资者。

最后,预祝烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演圆满成功!谢谢大家!

烟台德邦科技股份有限公司 董事、总经理陈田安先生致结束语



尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友:

大家好!

今天的网上交流即将结束,感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问,同时也感谢上证路演中心和中国证券网所提供的交流平台和良好服务,感谢东方证券承销保荐有限公司以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动!在本次网上路演即将结束之际,我谨代表烟台德邦科技股份有

限公司,再次感谢各位的热情参与!

通过今天的网上路演活动,各位投资者朋友从主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和战略规划等多个方面,与我们进行了深入的交流,希望能够帮助大家更加深入地了解公司价值。同时,大家提出了很多宝贵的意见和建议,我们将予以认真听取和吸收,付诸实践,创造出更好的业绩来感谢大家的关心与厚爱。

通过与大家的沟通,我们深深体会到作为一家公众公司所承担的使命与责任。步入上市公司行列后,我们将面临更多投资者的关注、关心与监督,这也将是德邦科技未来做大、做强、健康发展的有力保障。

由于时间关系,我们无法一一回答投资者提出的问题,但真诚地希望大家继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。

最后,再次感谢广大投资者对德邦科技的支持和关心,希望我们携手共进,创造和分享更加美好的未来!祝大家投资顺利、万事如意!谢谢大家!